

8410 HS



Produkt Information

60µm reaktiver hitzeaktivierbarer Film

Produktbeschreibung

tesa HAF® 8410 ist ein hitzeaktivierbarer Film auf Basis von Nitrilkautschuk und Phenolharz und ist mit einem Papierliner abgedeckt.

Das Material ist bei Raumtemperatur nicht klebend und lässt sich deshalb gut schneiden und stanzen. Die Prozesstemperatur zur Vorfixierung liegt bei ca. 90°C. In einem zweiten Verarbeitungsschritt wird das Produkt unter Hitze und Druck appliziert.

Nach voller Aushärtung erreicht tesa HAF® 8410 eine extrem hohe Verbundfestigkeit sowie exzellente Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit. Dabei bleibt die Klebfuge elastisch.

Produktmerkmale

- Reliable chip module bonding
- Suitable for PVC, ABS, PET, and PC cards
- Good workability on all common implanting lines
- Outstanding ageing resistance
- Lifelong flexibility due to high rubber content

Anwendung

tesa HAF® 8410 ist speziell entwickelt worden für das Implamentieren von Chipmodulen in Smart Cards. Zusätzlich ist das Produkt zum Verkleben von temperaturbeständigen Materialien wie Metall, Glas, Kunststoff, Holz und Textilien geeignet.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|---------------------|------------------------------|---------|-----------------|
| • Trägermaterial | ohne | • Dicke | 60 µm |
| • Klebmasse | Nitrilkautschuk & Phenolharz | • Farbe | bernsteinfarben |
| • Art der Abdeckung | Trennpapier | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | |
|--|----------------------|
| • Haftfestigkeit (dynamische Scherung) | 12 N/mm ² |
|--|----------------------|



8410 HS

Produkt Information

Weitere Informationen

Verarbeitung:

1. Vorlaminierung:

tesa HAF® 8410 wird zwischen ca. 90 °C und 110 °C klebrig.

2. Aushärtung:

Die Verklebungsparameter Temperatur, Druck und Zeit sind von der Anwendung und den zu verklebenden Materialien abhängig. Als Richtlinie gilt:

Splicing-Anwendungen:

Temperatur: 120 °C - 200 °C

Druck: > 2 bar

Zeit: 15 sec. - 30 min.

Verkleben von Kupplungsbelägen:

Temperatur: 180 °C - 230 °C

Druck: > 6 bar

Zeit: 1 min. - 30 min.

Für das Erreichen der maximalen Verbundfestigkeit sollten die Untergründe sauber und trocken sein.

Lagerbedingungen gemäß tesa® HAF Haltbarkeitskonzept.

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=08410>